附件1：

2024年苏州工业园区集成电路产业发展

专项资金项目申报指南

2024年苏州工业园区（下称“园区”）集成电路产业发展专项资金重点支持园区内集成电路领域的企业融资、对上争取、产业强基、产能合作、场景应用和品牌发展等方向，为集成电路产业高质量发展提供有力支撑。

1. 支持企业融资

（一）支持条款

对于符合园区集成电路产业发展重点领域的重点企业，首轮融资获得知名股权投资机构入股的，经遴选，采用拨投结合的方式，按不超过基金实际投资的10％、给予最高500万元的一次性奖励；同时，园区国有投资基金参与支持。

（二）申报要求

本次申报支持项目应符合园区集成电路“6+2”（集成电路芯片设计、高端制造、先进封测、关键设备、核心材料、自主软件六大主赛道，微机电系统（MEMS）、第三代半导体两大特色领域）产业方向，首轮融资获清科榜单入选投资机构或其他知名投资机构入股。项目首轮融资完成工商股权变更登记的日期应介于2023年1月1日（含）至2023年12月31日（含）之间。

（三）申报材料

1. 项目申报书（2.1支持企业融资）
2. 股权投资机构实缴出资的证明材料（投资协议、出资的银行转账记录、企业股权工商变更登记通知书（从注册开始）等）
3. 真实性承诺书
4. 支持对上争取
5. 支持条款

鼓励企业申报国家先进制造业和现代服务业、产业基础再造（制造业高质量）、核心装备（技术）攻关等集成电路领域重大专项，经遴选，成功企业给予所获财政拨款额最高50%的奖励，同一项目奖励金额不超过1000万元；对集成电路企业申报江苏省战略新兴产业、科技成果转化、“专精特新”、“智能工厂”、“首台套”等给予申报名额倾斜。对入选国家鼓励清单的重点集成电路企业、获评“中国芯”优秀产品以及江苏省、苏州市集成电路领域荣誉的，给予最高100万元奖励。

1. 申报条件

本次申报支持**2023年内**获评以下集成电路领域重大专项或荣誉的企业：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **荣誉/项目** | **奖补标准（万元）** |
| 1 | 国家先进制造业和现代服务业重大专项 | 对获评集成电路方向相关项目的，给予不超过所获财政拨款额50%，不超过1000万元奖励 |
| 2 | 产业基础再造（制造业高质量）项目 |
| 3 | 核心装备（技术）攻关 |
| 4 | 获评“中国芯” | 20 |
| 5 | 江苏省集成电路领域重要荣誉 | 50 |
| 6 | 苏州市集成电路领域重要荣誉 | 20 |

1. 申报材料
2. 项目申报书（2.2 支持对上争取）
3. 荣誉认定或项目立项、认定及拨款文件
4. 真实性承诺书
5. 支持产业强基
6. 支持条款

对于集成电路装备、材料企业的产品进入国内外知名企业进行验证的，经遴选，按不超过进场验证费用的20%给予补贴，单个企业年度最高补贴500万元。

1. 申报要求

企业产品进入芯思想研究院（ChipInsights）、世界半导体贸易统计组织（WSTS）或其他行业权威榜单企业进行验证，产品验证费用发生日期应介于2023年1月1日（含）至2023年12月31日（含）内。

1. 申报材料
2. 项目申报书（2.3 支持产业强基）
3. 专项审计报告
4. 验证服务合同及发票
5. 真实性承诺书
6. 支持产能合作
7. 支持条款

对为集成电路设计企业自主研发产品提供生产线产能的制造企业，最高按每款产品订单实际生产费用的20%给予奖励，单个制造企业年度最高奖励1000 万元。

1. 申报要求

本次支持产能合作项目支持本地化集成电路产品研发的产能合作项目，项目应完成于2023年1月1日（含）至2023年12月31日（含）之间。

1. 申报材料
2. 项目申报书（2.4 支持产能合作）
3. 专项审计报告
4. 产能合作合同及发票
5. 真实性承诺书
6. 支持场景应用
7. 支持条款

鼓励国资公司、终端厂商、集成商等开放场景、主动“发榜”，试用集成电路企业产品和服务，联合开展项目攻关。对于使用非关联本地集成电路企业产品和服务、年使用金额100 万元以上的，经遴选，给予场景应用项目实施方（集成电路企业）最高50万元奖励。

1. 申报要求

本次支持项目应入选2023年度园区集成电路新产品新技术应用场景，且相关产品2023年在园区客户内（非关联方）使用金额或在园区内场景建设应用金额达 100 万元以上。

1. 申报材料
2. 项目申报书（2.5 支持场景应用）
3. 专项审计报告
4. 产品和服务场景应用合同及发票
5. 真实性承诺书
6. 支持品牌发展
7. 支持条款

对主办国家级集成电路产业重大活动的，给予主办方实际开销最高30%的补助，每场不超过50万元。经遴选，对企业参加集成电路领域的重要会展、活动，单场给予参展费用最高50%、不超过20万元补助，年度补助不超过100万元。

1. 申报要求

本次支持的集成电路领域会展、活动包括2023年内举办的上海semicon展、上海慕尼黑电子展、南京世界半导体大会、合肥世界集成电路大会、深圳电子信息博览会或其他重要行业会展、活动，根据企业参展费用按比例及额度进行奖补。

1. 申报材料
2. 项目申报书
3. 活动举办/参展合同及发票
4. 其他证明材料
5. 真实性承诺书

注：本次申报中，企业可以不同项目同时申报多个方向，根据申报项目情况分别确定是否符合奖补要求。